

# tesa® 60744

## 产品信息



### 50 µm 导热胶带

tesa® 60744 是一款无基材的导热胶带，专用于电子设备的热源元器件或热传导材料中，要求高导热率的粘接，如：显示屏粘接，MLB粘接和元器件粘接等。

#### 产品特性：

- 高导热性
- 高粘
- 优秀的表面浸润性
- 易于处理
- 薄结构设计
- 高绝缘性

#### 主要应用

- 元器件粘接（需要热传导）
- 从MLB/FPC到散热器的散热应用
- 显示屏粘接和热传导到其他介质
- 蒸发器或热管粘接
- 天线粘接
- 石墨片粘接

#### 技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

#### 技术参数

• 基材	无	• 离型纸类型	PET（聚酯）薄膜
• 颜色	白色	• 离型纸颜色	透明
• 总厚度	50 µm	• Breakdown voltage	2.9 KV
• 胶粘剂类型	丙烯酸	• Thermal conductivity z-direction	1 W/mK

#### 粘接至

- 钢表面粘接强度(初始) 5.0 N/cm

# tesa<sup>®</sup> 60744

产品信息



## 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问  
<http://l.tesa.com/?ip=60744>